

大疆 Pocket 4 为何“反向”定价?



图为大疆近期刚发布的 Osmo Pocket 4

本报记者 周晓阳

在消费电子上游供应链成本(尤其是存储芯片)高企的当下,科技产品的定价策略往往水涨船高。然而,大疆近期刚发布的 Osmo Pocket 4 却上演了一出有点儿“反常”的戏码:按理说,在上二代 Pocket 3 大获成功的基础上,大疆完全可以采取“趁势涨价”的迭代策略,出人意料的是, Pocket 4 全能套装的首发价不仅比上一代降了整整 700 元,还直接附赠了 107G 的内置存储。在存储产品价格大涨的今天,大疆为何要对新一代产品“增配降价”、强行“卷”自己?答案或许就隐藏在产品体验的细节与商业生态的竞争之中。

提升体验“微雕”版

综合来看,大疆最新发布的 Osmo Pocket 4 并非一次大开大合的器材革命,而是一场针对痛点的“微雕”升级。

从官方释放的参数看, Pocket 4 搭载了全新 1 英寸 CMOS, 防抖升级, 动态范围拉升至 14 档, 且支持

2 倍无损变焦。但在记者的实际体验与参数对比中,其肉眼感知的画质差距并没有与上一代拉开鸿沟,且机身的发热问题仍是不容忽视的短板。

然而,机器的细节优化却精准切中了高频使用的痒点。全新的滑杆设计让触感和操控力矩更顺手;支持主机供电的磁吸补光灯解决了复杂光线下的拍摄难题;新增的手势控制和更智能的人脸跟随,使其成为“单兵作战”的得力工具,极大地丰富了单人作业的便利性。

基于此,《中国电子报》记者提出购买建议如下:如果你已经是 Pocket 3 的重度用户,尚未迎来质变的四代并不急需升级;但对于尚未入坑的新用户,降价增配的 Pocket 4 无疑是当下的最优解之一。

深耕“场景依赖”

基于此,再看大疆此次新品的定价策略,便能揣摩一二。

正如益普索与京东 3C 数码联合发布的《AI 消费电子洞察报告》显示,大众对智能硬件的需求已全

面进化为深度的“场景依赖”。映射到真实的市场中,如今撬动百亿级影像市场增量的,恰恰是那些对传统复杂设备“敬而远之”的大众群体——穿梭于演唱会的“特种兵”、记录家庭日常的新晋父母、热衷打卡的银发一族,等等。

以火爆的演唱会“特种兵”为例:内置 107G 的内存让人告别“忘带存储卡”的焦虑;14 挡动态范围和 2 倍变焦,刚好能适应舞台复杂的强弱光并看清细节;轻便的体量,让连续举拍数小时在体力上完全可行。这或许正是它能在粉丝圈长期受追捧的原因。在场景为王的逻辑下,大疆看准了这一细分市场。

从竞争格局来看,大疆的护城河正遭遇影石 (Insta360) 等老对手,甚至如 OPPO、vivo 等各大手机厂商在影像层面的跨界围剿。大疆此时的“增配降价”,实则是用性价比优势,去压缩新玩家入局的定价空间。

这场博弈也印证了一个核心趋势:好的科技产品正在变得越来越“隐形”且全能——它会把复杂的运算留给机器,让普通人只享受科技带来的易用与便利。

阿里巴巴未来一年 AI 相关产品收入占比将突破 50%

本报 记者陈存报道:5月13日,阿里巴巴发布 2026 财年 Q4 (对应自然年 2026 年 Q1) 财报,截至 2026 年 3 月 31 日,阿里巴巴收入 2433.8 亿元,同比增长 3%。

一批 AI 相关的亮眼数字同步露出。财报显示,本季度,阿里 AI 相关产品收入达 89.71 亿元,连续第 11 季度实现三位数同比增长, AI 年化收入达 358 亿元。AI 相关产品收入在阿里云外部商业化收入中的占比首次突破 30%。阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示,预计未来一年, AI 相关产品收入的占比将突破 50%, 成为推动云业务收入增长的主要引擎。吴泳铭指出,阿里全栈 AI 技术投入已正式跨越初期培育阶段,进入正向的规模商业化回报周期。

喜忧参半的是,本季度阿里自

由现金流为净流出人民币 173 亿元,相比 2025 年同期由正转负。阿里巴巴首席财务官徐宏回应称,其背后的主要原因是阿里在 AI 方面的投入,“我们看到了这样一个历史机遇,这个窗口期对我们来讲可能就是几年的时间”。他强调,在未来两年的窗口期内,阿里仍会坚定投入 AI。

徐宏表示,目前公司约持有 380 亿美元净现金,如果剔除五年以上到期的债务,净现金约有 590 亿美元,且公司拥有强大的资本市场融资能力,足以筹集充足的现金流。同时,随着闪购业务亏损收窄, AIGC 业务逐步实现盈利,阿里整体的经营现金流将会呈现正向发展态势。

吴泳铭进一步透露了未来阿里

在 AI 投资方面的计划,他将 AI 行业类比为制造业,强调要建立 AI 训练和 AI 推理两个核心工厂,并加大对 AI 数据中心的投入。“两个工厂背后其实是 AI 数据中心的建设,一定会消耗比较大的自由现金流,但在回报路径上是清晰的,未来三年到五年的回报是确定的。”他还透露:“目前我们服务器上没有一张卡是闲置的。”

2025 年 2 月,阿里宣布未来三年投入 3800 亿元建设云和 AI 硬件基础设施。此次电话会上,吴泳铭表示,为实现未来的营收目标,阿里云所持有的数据中心资产将是 2022 年大模型爆发前的 10 倍以上,为了获取这些算力中心,阿里投入的资金会远超过原来预期的 3800 亿元。

百度发布多项 AI 成果

本报 记者陈存报道:5月13日, Create2026 百度 AI 开发者大会在北京举办。会上,百度发布了多个涉及大模型、智能体、AI 基础设施等全栈 AI 体系的重磅成果。百度创始人李彦宏强调,为支撑智能体应用爆发,百度作为平台型公司,已构建起“芯云模体”全栈能力。

“AI 人口在重建,人机关系在重塑,组织形态在重构。我们正在进入一个全新的生产力时代。”李彦宏表示。他认为,智能体的出圈代表着 AI 的发展正从模型阶段走向应用阶段,“第一次, AI 的主角不是模型,而是应用”。

对此,李彦宏提出, AI 时代新的度量衡不是 Token, 而更可能是“日活智能体数”(Daily Active Agents, DAA)。他认为, Token 代表成本而非收益,衡量的是投入而非产出,想要“衡量一个平台和生态的繁荣,更应该看的是 DAA 这

个指标,关注有多少 Agent 在给人干活,并交付结果”。他进一步预测,未来全球日活智能体数可能超过 100 亿个。

开幕式上,百度集中发布和升级通用智能体 DuMate、代码智能体秒哒、数字人智能体百度一镜、自我演化决策智能体伐谋等系列产品。

DuMate (中文名“百度搭子”)是百度推出的类“龙虾”智能体,具备云端协同、安全可控、自我进化等特点。据了解, DuMate 将百度 AI 搜索、秒哒、伐谋、百科等核心产品能力集成为可随时调用的内置技能,同时强化长程任务执行与主动决策能力,目前已在多个国际权威 Agent Benchmark 评测中达到 SO-TA 水平。

代码智能体秒哒 APP 及企业版同步发布。据百度透露,秒哒本身 90% 的代码由秒哒自动生成,截至目前,其生成的应用已累计服务

用户超 1000 万,应用价值达 50 亿元。李彦宏表示,“代码能力越来越重要,但代码本身正在变得不值钱”。“一次性软件”或者说“日抛型软件”变得合理。“这个市场很可能会被放大 10 倍”。

数字人智能体方面,百度慧播星升级为“百度一镜”,从主要应用于直播带货场景的数字人,升级为以数字人为特色、包含直播、视频、实时互动等多形态的全场景数字人平台,据悉,“百度一镜”可生成几分钟乃至数小时的高互动内容。

此外,自我演化决策智能体伐谋升级至 2.0 版本,聚焦生产排程、工艺优化、物流规划三大典型行业场景实现垂直能力的突破,将业务逻辑沉淀为可复用的 AI 资产。以物流规划领域为例,在自动化码头,伐谋帮助全球首套码头智能管控系统 A-TOS, 实现 10.21% 的绝对指标提升。

EDA/IP 行业研究报告

赛迪研究院

目录

第一章 引言

- 1.1 EDA 的定义和发展历史
- 1.2 IP 核的定义和发展历史

第二章 全球及中国市场现状

- 2.1 全球集成电路行业市场规模
- 2.2 我国集成电路行业市场规模
- 2.3 全球 EDA/IP 市场行业规模
- 2.4 我国 EDA/IP 市场行业规模
- 2.5 EDA/IP 行业趋势

第三章 数字 EDA 行业

- 3.1 数字芯片设计流程
- 3.2 数字功能验证
- 3.3 数字设计实现

第四章 泛模拟 EDA 行业

- 4.1 定义与重要性
- 4.2 市场现状与技术趋势
- 4.3 竞争情况

第五章 系统级 EDA 行业

- 5.1 定义与重要性
- 5.2 市场现状与技术趋势
- 5.3 竞争情况

第六章 IP 行业

- 6.1 接口 IP
- 6.2 处理器 IP
- 6.3 物理 IP 等

第七章 总结

第一章 引言

1.1 EDA 的定义和发展历史

集成电路是通过半导体工艺,将晶体管、电阻、电容等电子元件及互连线集成在微小基片上,完成特定电路或系统功能的微型结构。自 1958 年杰克·基尔比发明第一块集成电路以来,产业遵循“摩尔定律”持续演进,从大规模集成 (LSI) 到超大规模集成 (VLSI),直至今天的系统级芯片 (SoC) 和先进封装 (Chiplet) 时代,成为现代信息社会的基石。

EDA 工具 (Electronic Design Automation, 电子设计自动化) 是用来辅助集成电路设计生产的工具,贯穿芯片设计、制造、封装、测试全流程。随着芯片规模的增大和制造工艺的发展,基于先进节点的集成电路规模可达数十亿个晶体管,依靠手工难以完成相关工作,要求在设计方法和工具上进行变革,以适应自动化、程序化、AI 化、最优化的设计要求。

EDA 技术历经手工设计阶段、计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助制造 (CAM)、计算机辅助测试 (CAT) 和计算机辅助工程 (CAE) 等发展历程,已经成为电子信息产业的支柱产业。在 20 世纪 60 年代以前,芯片设计依赖手工绘制电路图,随着集成电路晶体管密度增加,这种方法效率低下、错误率高,已无法满足设计需求;进入 20 世纪 70 年代,计算机辅助设计 (CAD) 时代开启,利用二维平面图形工具进行电路原理图编制、PCB 布局布线和简单的 IC 版图编辑,实现了设计过程的部分自动化,同期 SPICE 仿真工具在加州大学伯克利分校诞生,成为模拟电路仿真的行业标准。20 世纪 80 年代进入计算机辅助工程 (CAE) 阶段,实现了逻辑综合、自动布

局布线、时序分析等核心功能,各个独立的 CAD 工具被集成为系统,硬件描述语言如 VHDL 和 Verilog 也相继诞生, Daisy Systems、Mentor Graphics 等 EDA 公司成为行业先驱。1990 年至 2010 年,现代 EDA 阶段通过高级语言描述、系统级仿真和综合优化技术,覆盖从系统级到物理级的全流程设计,并形成了楷登电子 (Cadence)、新思科技 (Synopsys)、Mentor Graphics (2016 年被西门子收购) 三大巨头主导的市场格局。2010 年至今,随着摩尔定律趋近物理极限,芯片设计向超大规模 SoC 及 Chiplet 异构集成演进。这一阶段,EDA 从传统单点工具向具备软硬件协同、多物理场仿真能力的系统级平台跨越。“EDA 与 IP 深度融合”成为行业显著趋势,通过将预验证的 IP 核与自动化设计工具无缝集成,实现了设计与验证的端到端闭环。同时,人工智能技术开启了“AI for EDA”的范式变革,通过机器学习自主优化,EDA 正式演变为支撑全球智算产业与数字经济高质量发展的底层战略底座。

1.2 IP 核的定义和发展历史

IP 核 (Intellectual Property Core, IP 核) 是指在集成电路设计中经过验证、可重复使用的电路设计模块,是构建复杂 SoC 的基本单元。随着芯片集成度达到数十亿晶体管级别、产品上市周期缩短至数月,以及研发成本攀升至数亿美元,从零开始设计所有的电路模块变得既不经济也不现实,这催生了 IP 核复用方法论的普及,要求 IP 具备标准化、可配置、易集成等特性。根据 IP 核的实现方式和应用领域不同,可将其分为处理器 IP、接口 IP、物理 IP、数字 IP 等类型,按物理形态又可分为软核 (RTL 代码)、硬核 (版图网表) 和固核 (门级网表) 三种形态。

日趋完善。自 2010 年至今, Chiplet 技术兴起推动 Die-to-Die 互连 IP 和 Chiplet 设计服务成为新赛道, RISC-V 开源架构重塑处理器 IP 生态, IP 已成为支撑移动计算、人工智能、自动驾驶等万亿元级应用市场的技术基石。

第二章 全球及中国市场现状

2.1 全球集成电路行业市场规模

2025 年全球集成电路市场规模将增至 6778.52 亿美元。全球半导体贸易统计组织 (WSTS) 统计数据,随着存储芯片市场的强劲复苏,以及逻辑、模拟芯片的稳步增长, WSTS 预计 2025 年全球集成电路市场规模将增至 6778.52 亿美元,较 2024 年大幅增长 25.64%。AI 算力需求激增 (如英伟达数据中心收入同比增 192%) 是核心推动力, AIGPU、定制 ASIC 芯片需求持续超过供应。

2.2 我国集成电路行业市场规模

我国集成电路产业虽起步较晚,但近年来发展迅速,增速持续领先全球。在国家与地方各级产业政策支持、集成电路产业投资基金与地方专项基金推动,以及社会各界共同努力下,我国集成电路产业实现从小到大、由弱渐强的跨越,企业创新能力不断提升,已在全球产业链中占据重要一席,并在部分细分领域初步形成国际领先的研发与技术能力。

(以上为《EDA/IP 行业研究报告》节选内容,如需完整报告,请联系 re-search_CCID@163.com)